

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC6223xxxx9R-G
標準質量: 1 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.090	シリコン	89600	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	0.099	ニッケル	98500	7440-02-0
	0.009	銀	9400	7440-22-4
	0.001	金	1100	7440-57-5
ダイアタッチ	0.002	溶融シリカ	2000	60676-86-0
	0.002	エポキシ樹脂	2000	—
ボンディングワイヤ	0.047	金	47300	7440-57-5
封止樹脂	0.675	溶融シリカ	675100	60676-86-0
	0.045	エポキシ樹脂	45000	—
	0.030	フェノール樹脂	30100	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。